

証券コード：6599

EBRAIN エブレン株式会社

The background of the slide is a futuristic cityscape with a blue and white color scheme. The buildings are stylized and appear to be constructed from circuitry or data lines. A bright light source is visible in the upper right quadrant, creating a lens flare effect. The word "EBRAIN" is prominently displayed in the center in a bold, red, sans-serif font.

EBRAIN

個人投資家向け I R セミナー

2024年11月23日(土)
代表取締役社長 上村 正人

- 会社概要
- 事業内容の説明
- 2025年3月期(第52期)上半期決算状況
- 2025年3月期(第52期)通期見通し
- 成長への取り組み

設	立	1973年（昭和48年）10月		
本	社	東京都八王子市石川町		
資	本	金	1億4,301万円	
売	上	高	39億8,700万円（2024年3月期）	
経	常	利	益	4億9,000万円（同上）
従	業	員	数	121名（2024年3月現在）
事	業	所	東京都八王子市、東京都荒川区、埼玉県入間市、大阪市東淀川区	
子	会	社	蘇州エブレン（蘇州惠普聯電子有限公司：中国江蘇省蘇州市）	
事	業	内	容	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計製造販売

- 現在のメインの仕事内容は、
通信・電力・鉄道・医療などの「**社会インフラ系設備**」および
半導体製造装置や生産自動化機械などの「**産業インフラ系設備**」に、
コントローラとして使用される**産業用コンピュータ**の
受託設計と受託生産が中心で、売上の80%以上を占めています。

通信・放送



- 鉄道・電力・通信などの公共性の高い事業会社向け設備の開発や調達は、
大手の装置メーカーが主契約者となっていて、私どものビジネスのポジシ
ョンとしては、その下になります。

鉄道



- 主契約者の装置メーカーは、設備やシステムの開発構想に基づいて、
当社へ委託するコンピュータ製品の「**要求仕様書**」を作成して提示し、
私共はその「**要求仕様**」に基づいて**製品を設計**し、試作品を作って装置
メーカーへ送り、評価と設計検証を受けます。

医療

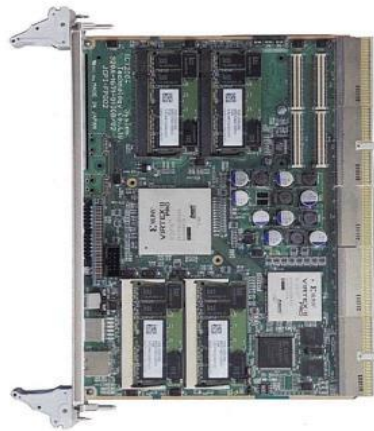


- 量産に入る迄に半年とか一年以上の期間を要する事もありますが、
量産開始以降は中長期的に安定した製品供給を要求されます。

半導体製造装置



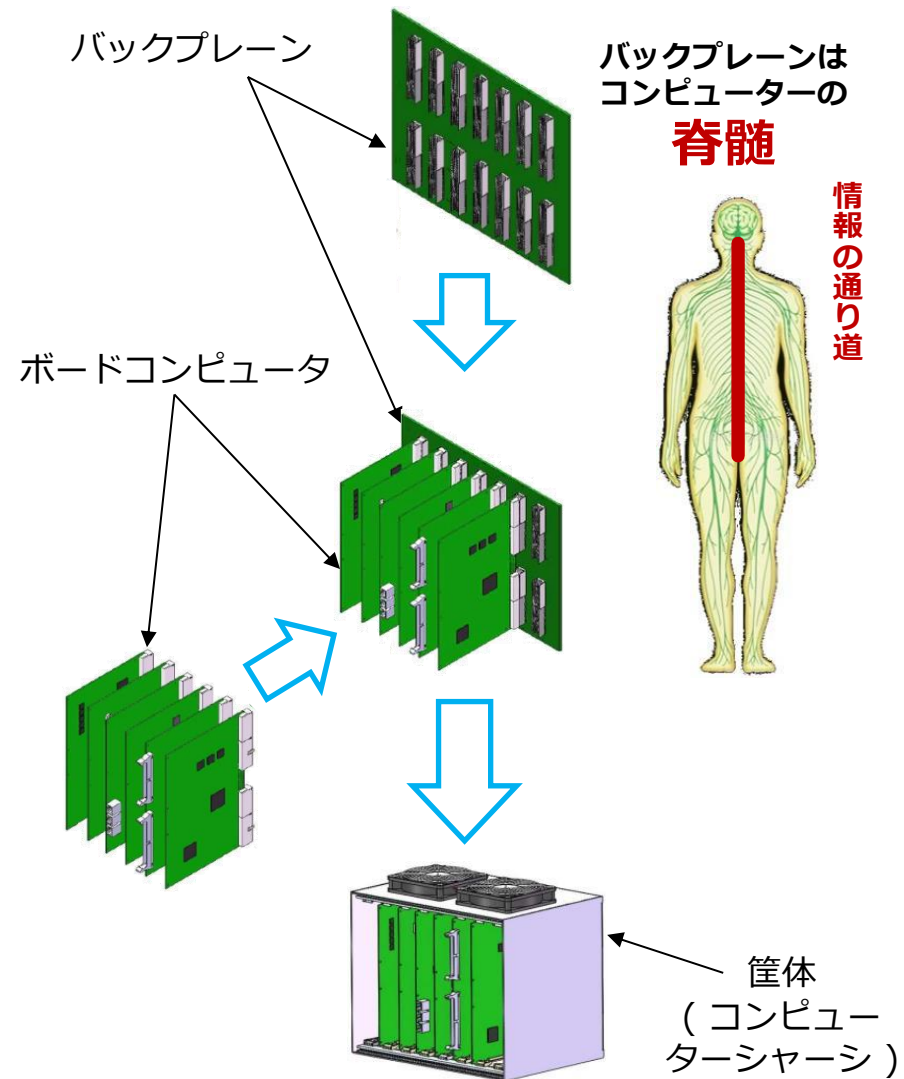
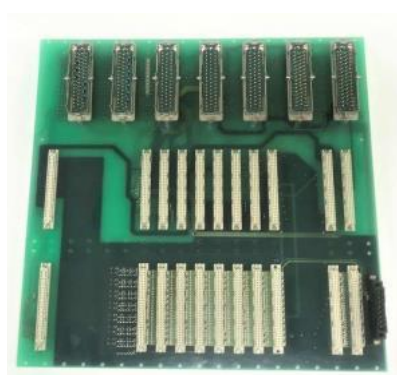
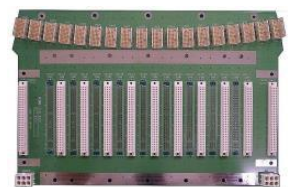
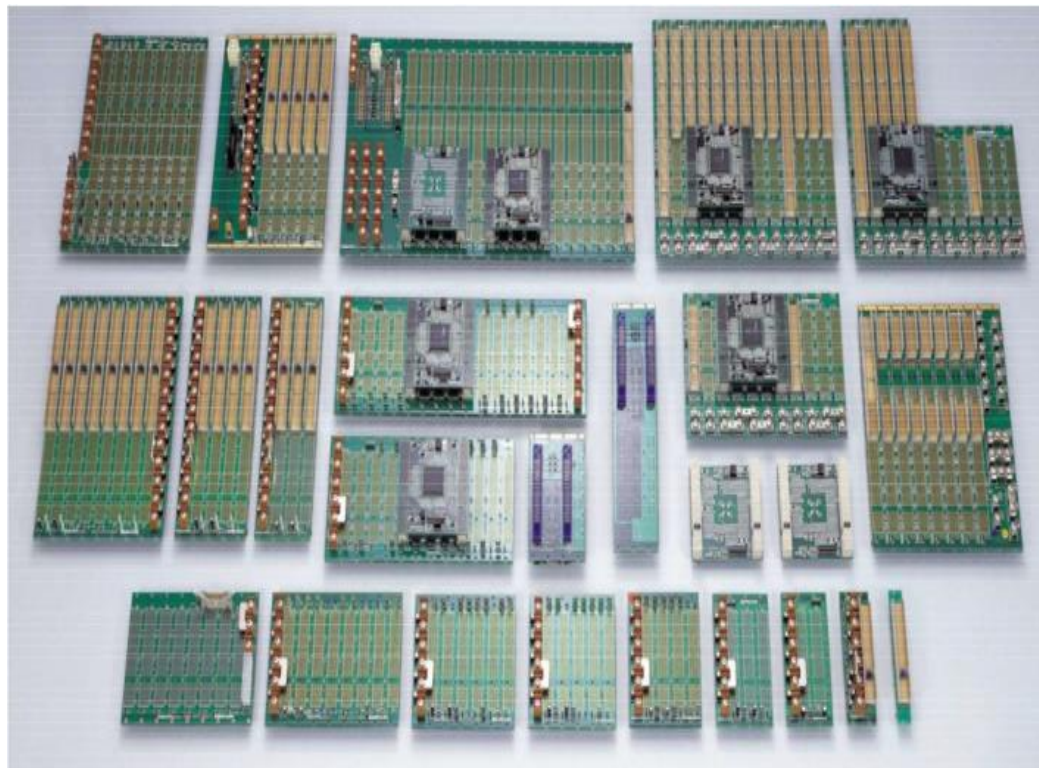
- バックプレーンシステム用
ボードコンピュータ



- IoT・Edge システム用
ワンボードコンピュータ



製品区分(2) バックプレーン

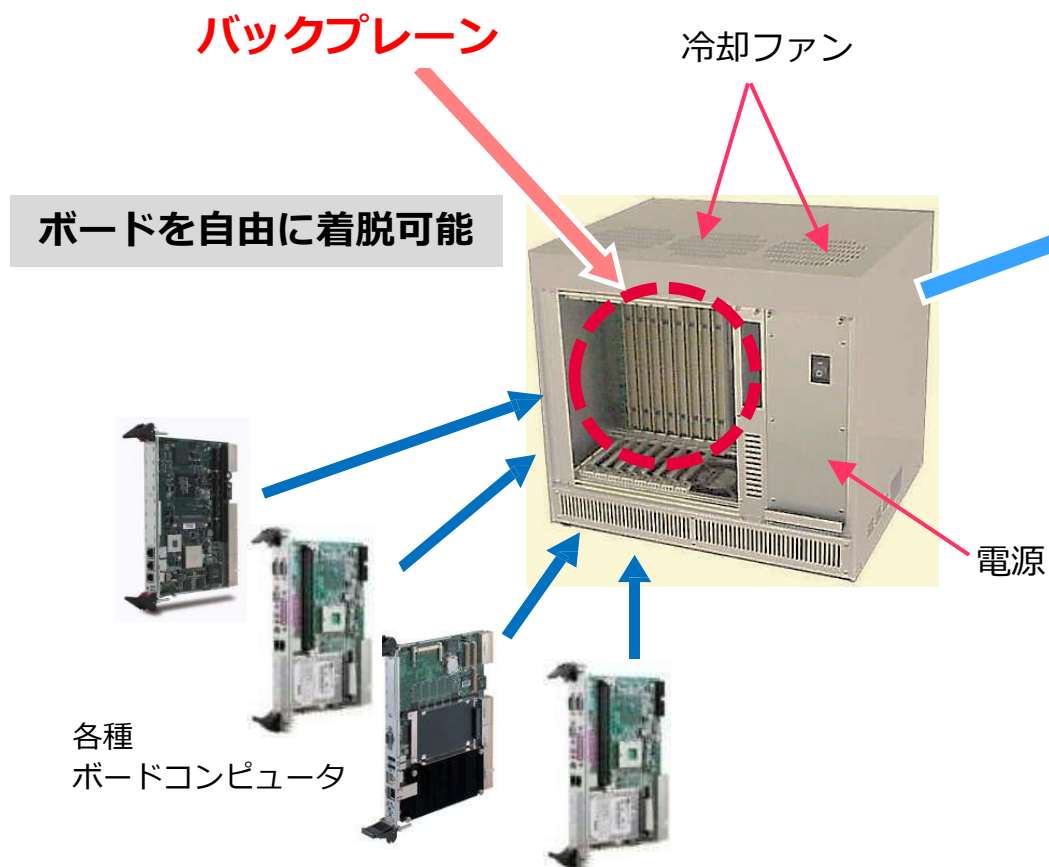


- バスラック
(バックプレーン搭載型シャーシ)



- ワンボード型シャーシ
(IoT・Edgeシステム用)





(例・半導体製造装置)

バックプレーン

【役割】
各種回路基板を相互に接続して
信号伝送や電力供給を行う

冷却ファン

筐体

ガイドレール

電源



ボードコンピュータ

【バックプレーン方式の利点】

ボードコンピュータが自在に着脱可能

1. 保守性

ホットスワップ、
保守体制、保守要員、

2. 拡張性

拡張スロット、増設、
機能追加、

3. 汎用性

市場に流通しているボードコンピュータ
を採用する事が可能。

多くの産業用コンピュータで
バックプレーン方式が採用される

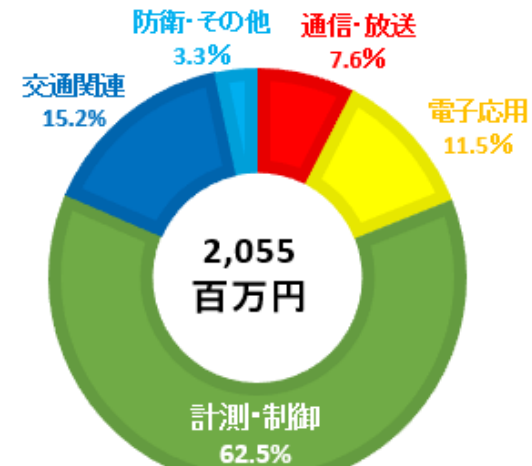
エブレン製品の用途（応用分野）

産業インフラ・社会インフラ関連の大手企業と安定的な取引関係を継続

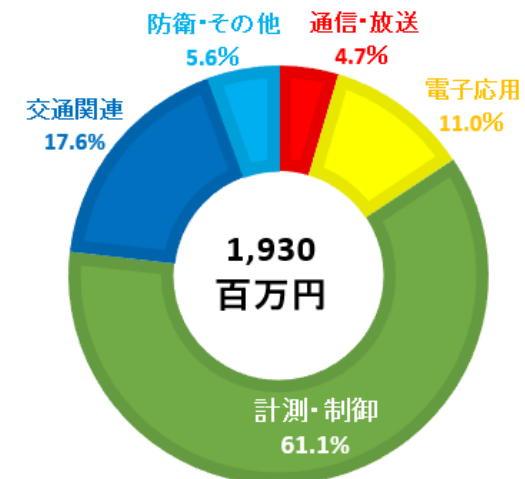


連結売上高構成前年同期比

2024年3月期上半期



2025年3月期上半期



主要納入先 (直接納入,間接納入を含む)

各分野の主要メーカーへ納入

NEC

NEC グループ各社

HITACHI
Inspire the Next

日立製作所
グループ各社

FUJITSU

富士通グループ各社

住友電工
Connect with Innovation

住友電気工業 (株)

GE Healthcare

GE Healthcare
グループ各社

Preferred Networks

(株) プリファード・
ネットワークス

三菱重工

三菱重工
グループ各社

MITSUBISHI ELECTRIC

三菱電機
グループ各社

Kawasaki

川崎重工業
グループ各社

TEL

東京エレクトロン
グループ各社

Canon

キヤノンメディカル
システムズ (株)

古河電工

古河電気工業 (株)

KYOSAN

(株) 京三製作所

viswill

第一実業ビスウィル (株)

Panasonic

パナソニック
グループ各社

TOSHIBA

東芝 グループ各社

Lasertec

レーザーテック (株)

OLYMPUS

オリンパスメディカル
システムズ (株)

Nikon

(株) ニコン

SCREEN

(株) SCREENセミコンダクター
ソリューションズ

日本信号株式会社

日本信号 (株)

SONY

ソニーグローバル
マニュファクチャリング&
オペレーションズ

MEIDEN

(株) 明電舎

TOKYO KEIKI

東京計器 (株)

Anritsu

アンリツ (株)

SAMSUNG

サムスン電子
グループ各社

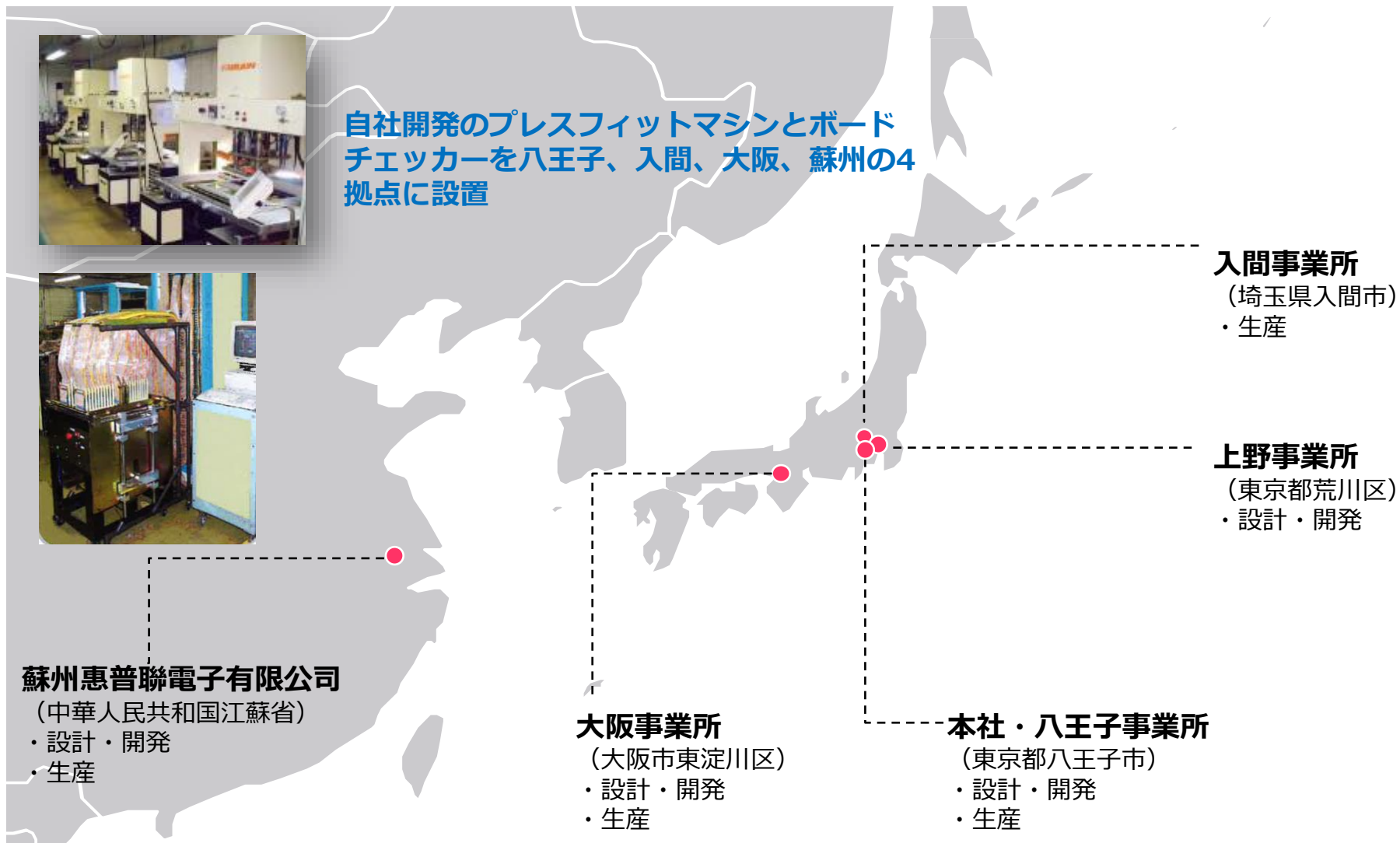
USHIO

ウシオ電機 (株)

ONO SOKKI

(株) 小野測器

BCPの観点から共通の設備で複数の生産拠点で生産



証券コード：6599

EBRAIN エブレン株式会社

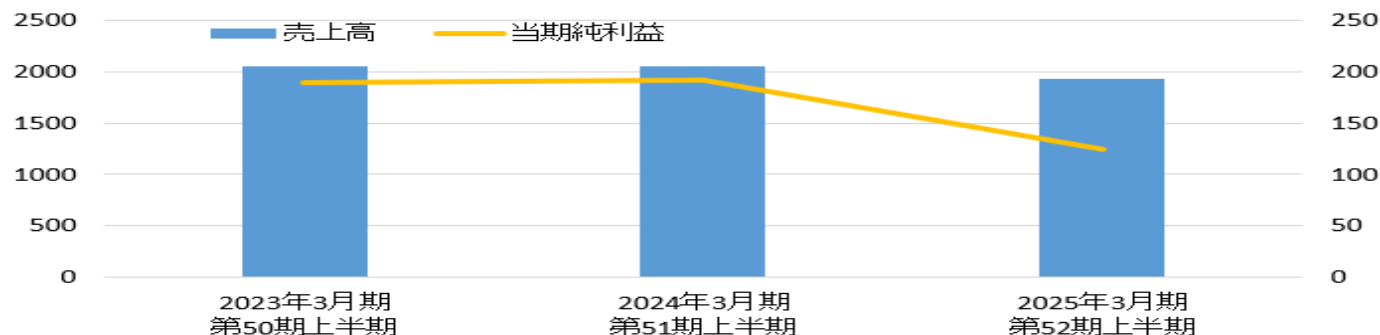


2025年3月期 上半期業績報告

2025年3月期 上半期決算実績

連結損益計算書	2023年3月期 上半期	2024年3月期 上半期	2025年3月期 上半期 (前年同期比)	上半期計画 (計画達成率)	通期計画 (計画進捗率)
売上高	2,052	2,055	1,930 (93.9%)	1,900 (101.5%)	4,100 (47.0%)
営業利益	300	287	188 (65.5%)	210 (89.5%)	530 (35.4%)
営業利益率	14.6%	13.9%	9.7%		
経常利益	289	290	189 (65.2%)	210 (90.0%)	530 (35.6%)
経常利益率	13.8%	14.1%	9.8%		
当期純利益	186	192	124 (64.5%)	140 (88.5%)	350 (35.4%)
当期純利益率	9.0%	9.3%	6.4%		

売上利益同期比較



単位：百万円



計測・制御 (半導体製造装置)

- ✓ 中国向けレガシー装置の設備投資が増加したが当社への影響は少ない
- ✓ 顧客の在庫未消化による生産調整が継続しており、高利益品の出荷減少
- ✓ 通期売上計画進捗率 1179/2510百万 (46.9%)
- ✓ 売上は前年同期比**8.1%減**

1,284百万円→1,179百万円 (104百万円↓)



交通関連

- ✓ 鉄道信号関連の新規案件量産開始
- ✓ 通期売上計画進捗率 340/695百万 (48.9%)
- ✓ 売上は前年同期比**9.0%増**

312百万円→340百万円 (28百万円↑)



通信・放送

- ✓ 電力分野は堅調に推移
- ✓ 通信・放送分野は大幅に減少
- ✓ 通期売上計画進捗率 89/265百万 (33.6%)
- ✓ 売上は前年同期比**42.2%減**
155百万円→89百万円 (65百万円↓)



電子応用

- ✓ 医療関連市場は堅調に推移
- ✓ 当社グループの顧客に一時的な生産調整に伴う売上減少
- ✓ 通期売上計画進捗率 213/455百万 (46.8%)
- ✓ 売上は前年同期比**9.5%減**
235百万円→213百万円 (22百万円↓)

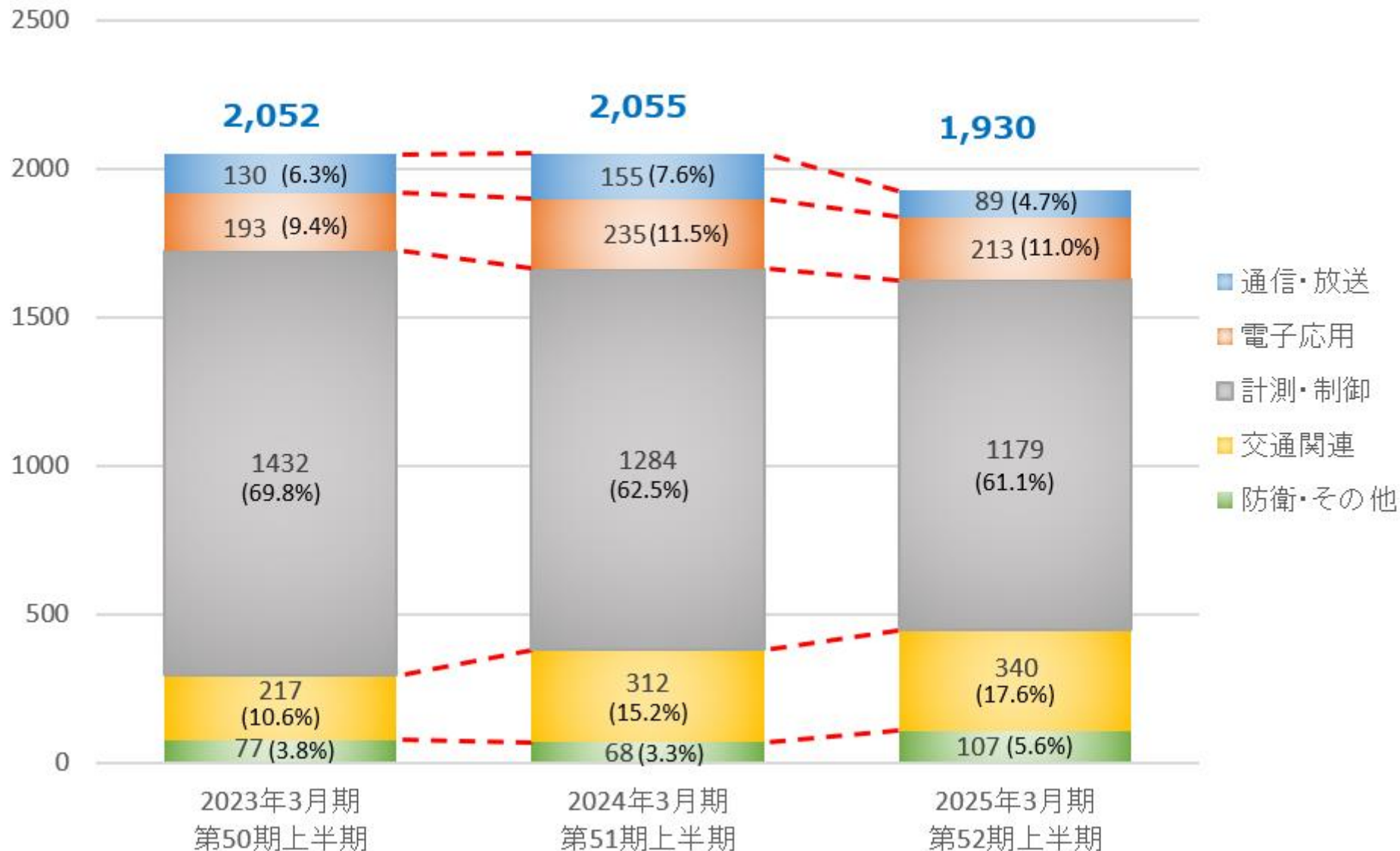


防衛・その他

- ✓ 新規案件成約により売上増
- ✓ 通期売上計画進捗率 107/175百万 (66.1%)
- ✓ 売上は前年同期比**58.1%増**
68百万円→107百万円 (39百万円↑)

連結応用分野別上半期推移

単位:百万円



2025年3月期 上半期業績 - 財政状態

	2024年3月 (百万円)	2024年9月 (百万円)	前期末比
流動資産	4,407	4,344	98.6%
固定資産	1,267	1,262	99.6%
資産合計	5,674	5,607	98.8%
流動負債	771	588	76.3%
固定負債	401	410	102.2%
負債合計	1,172	999	85.2%
純資産	4,502	4,608	102.4%
負債純資産合計	5,674	5,607	98.8%
自己資本比率	79.3%	82.2%	+2.9%

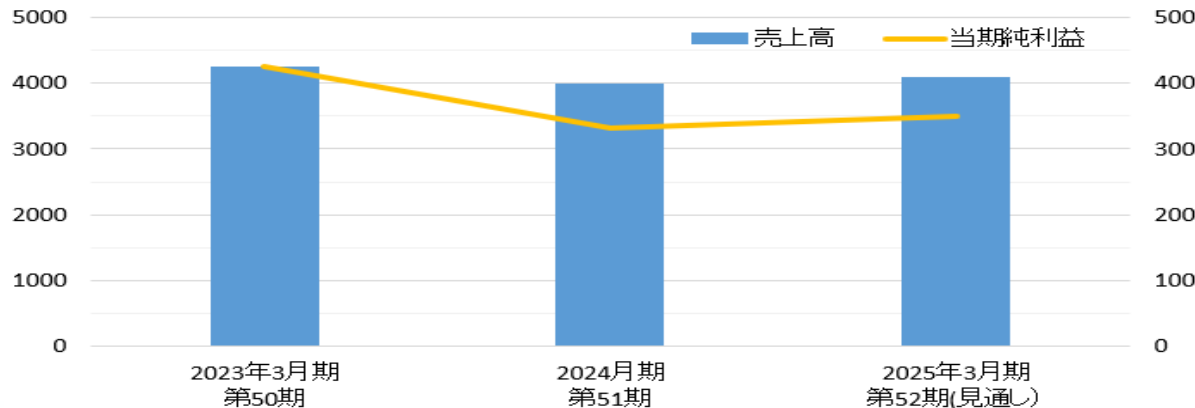
2025年3月期 通期予想

(期初の予想から変更なし)

単位：百万円

連結損益計算書	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期 見通し	増減率
売上高	4,258	3,987	4,100	102.8%
営業利益	656	486	530	109.0%
営業利益率	15.4%	12.1%	12.9%	
経常利益	654	490	530	108.1%
経常利益率	15.3%	12.2%	12.9%	
当期純利益	426	332	350	105.4%
当期純利益率	10.0%	8.3%	8.5%	
1株当たりの配当	27円	33円+5円※	40円	

※創立50周年記念配当



客先の在庫消化が進み、受注が回復傾向



計測・制御（半導体製造装置）

- ✓ AI用途などの先端分野は投資が旺盛
- ✓ 反対に低調な顧客もあり明暗が分かれている印象
- ✓ 客先の在庫消化が進み受注が回復傾向

交通関連



- ✓ 新規量産品の生産開始
- ✓ 他にも細かい設計案件が多数あり、量産化に期待

客先の在庫消化が進み、受注が回復傾向



通信・放送

- ✓ 電力分野は堅調に推移
- ✓ 通信・放送関係は従来機種 of 量産終息以降柱になるような案件無し



電子応用

- ✓ 医療機器関連は堅調に推移
- ✓ HPC関連案件は進展なし



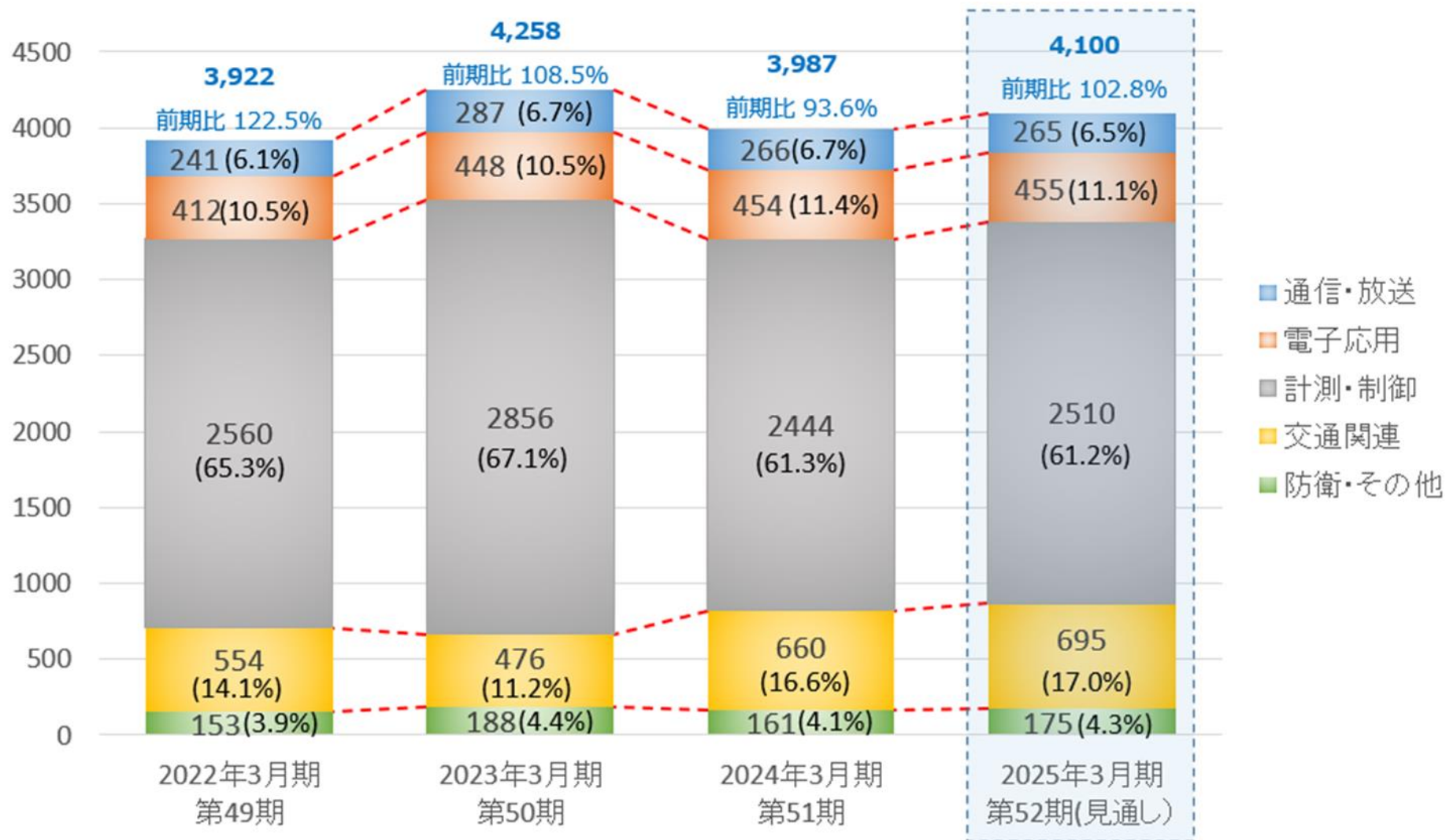
防衛・その他

- ✓ 新規案件成約により受注・売上共に増加

2025年3月期 通期応用分野別売上予想

連結応用分野別売上推移（期初の予想から変更なし）

単位：百万円





成長への取り組み

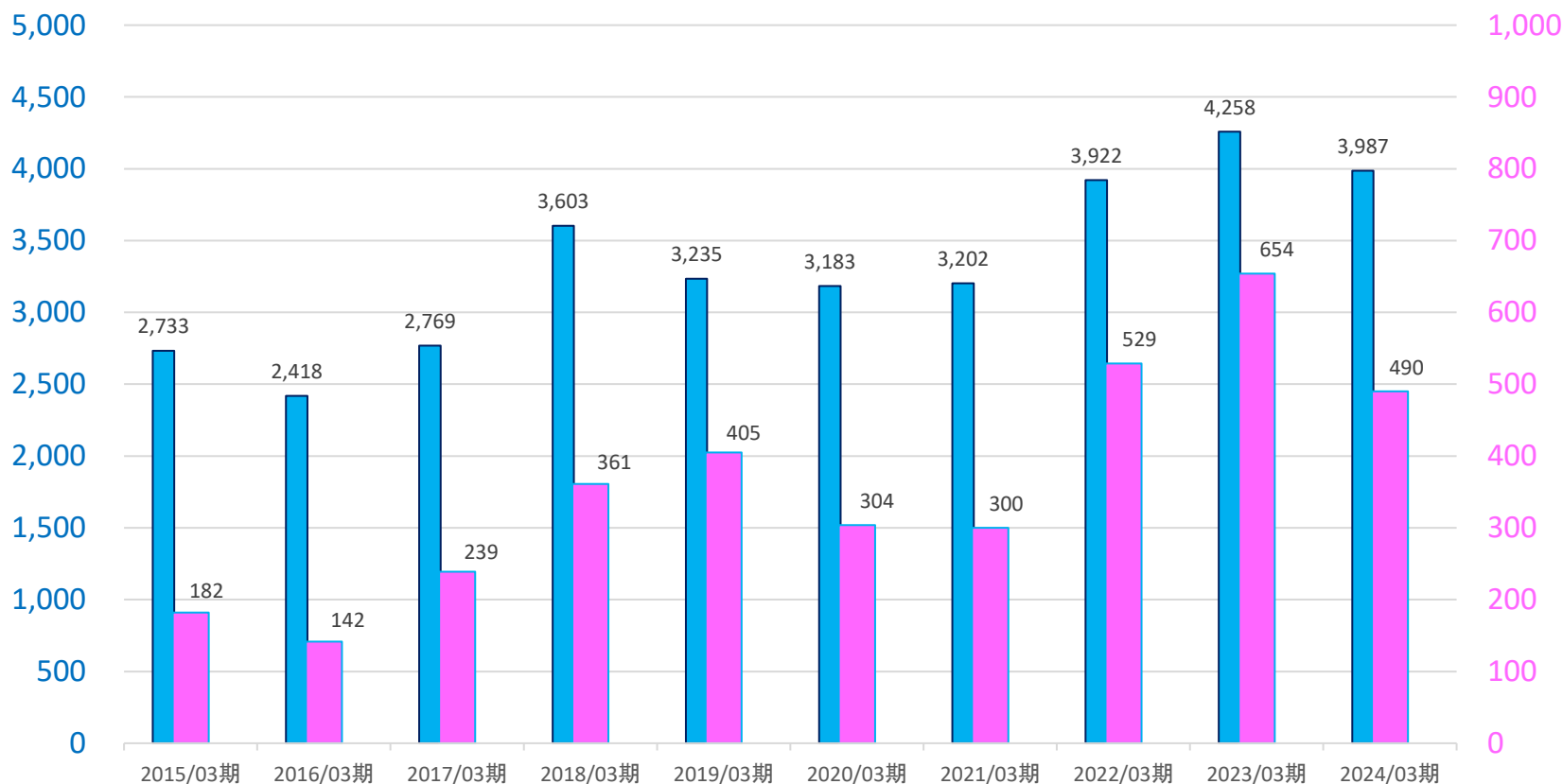
売上：27.3億円→39.8億円

経常利益：1.8億円→4.9億円

売上

売上・利益 推移(連結)

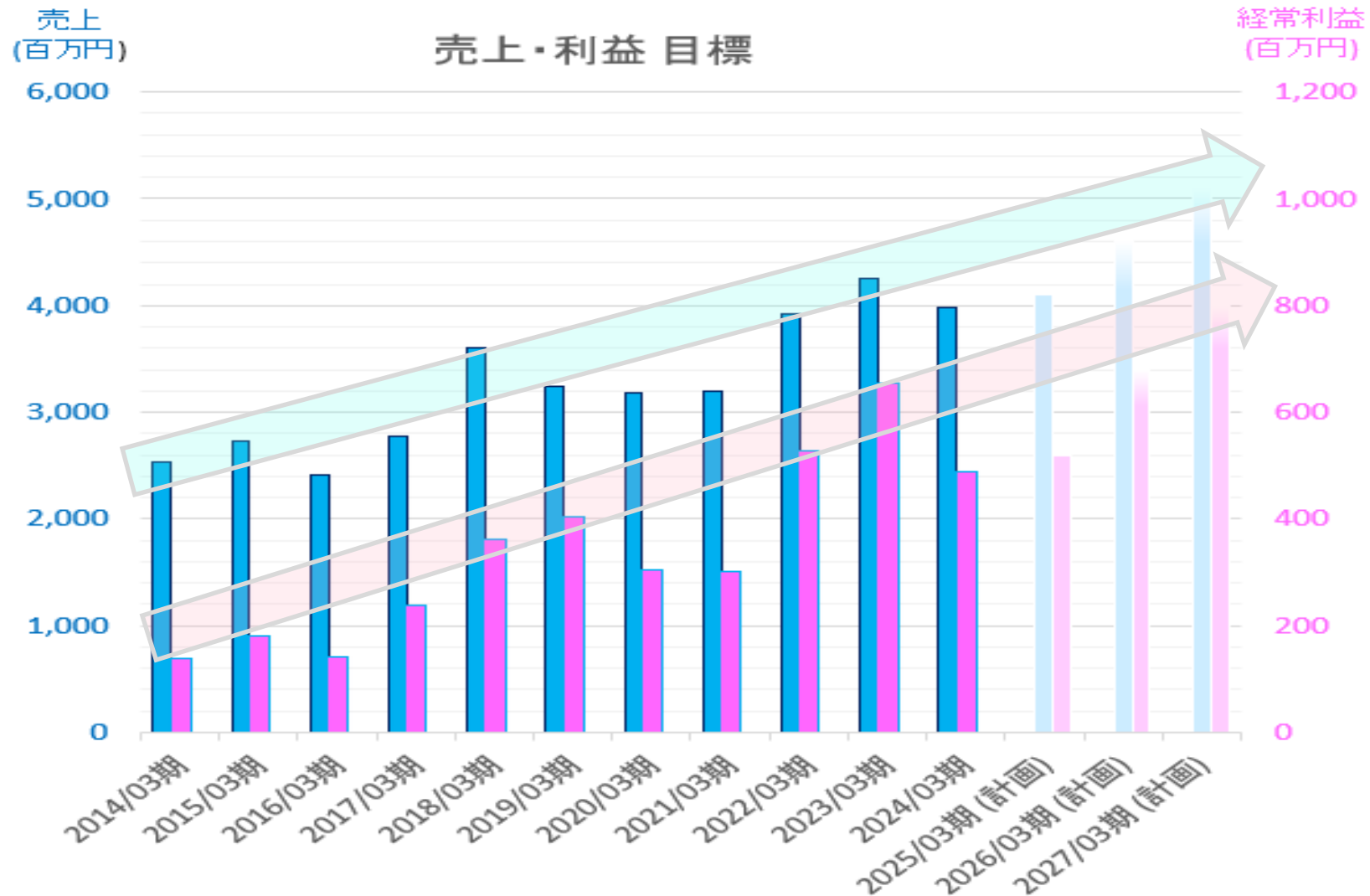
経常利益
(百万円)



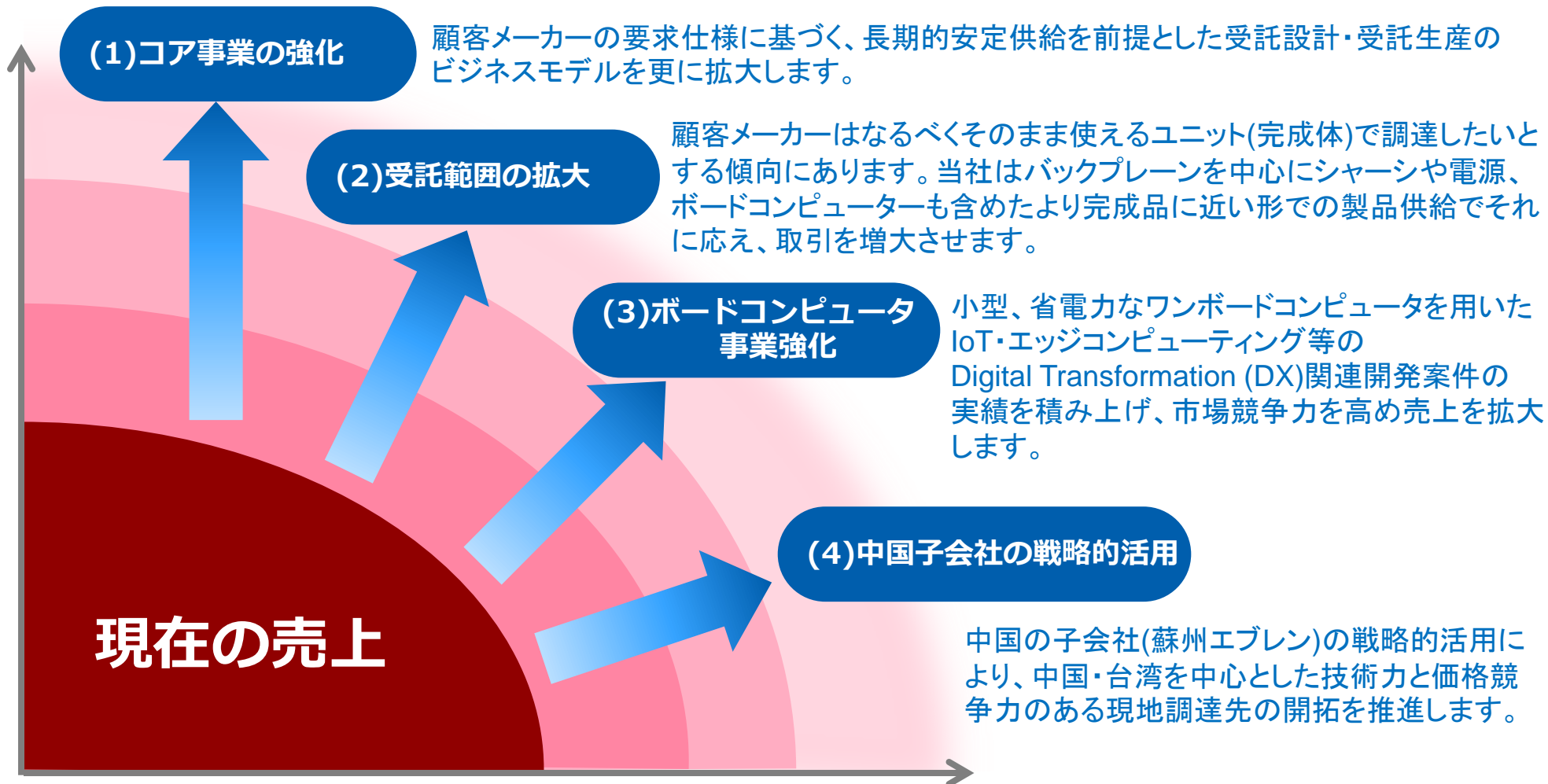
当面の目標

年率10%~15%成長を目標として成長路線を堅持

2027年3月期（54期）に売上51億円、経常利益8億円を目指す



より価値のあるソリューションの提供を通して企業価値の拡大を目指す



(1) コア事業の強化

顧客メーカーの要求仕様に基づく 受託設計・受託生産・長期的安定供給のビジネスモデルを更に拡大します。

大手システムメーカーの動向

過去

大手メーカーは設計・部材調達・生産など全てのプロセスを自社で完結していたが……

製品開発期間短縮の必要性の高まり

慢性的な技術リソース不足

技術の高度化・開発費の増大

今後

「選択と集中」が進み、ノウハウのある専門メーカーとの協業が拡大する

専門メーカーとしての優位性（**短納期・低コスト・高品質**）を生かし顧客メーカーとの協業を通じてノウハウや設計資産を蓄積

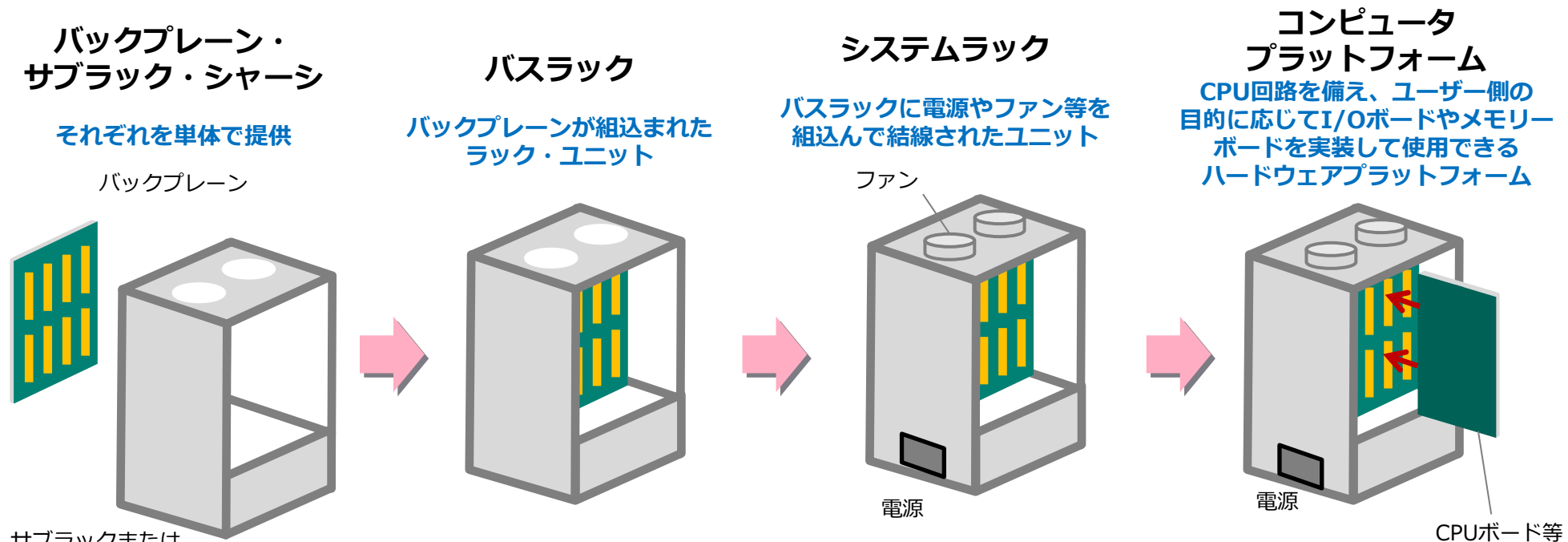
- ・類似案件の受注拡大
- ・事業領域の拡大
- ・要素技術の開発・拡充
(**冷却構造、耐電磁波構造等**)
- ・部品共通化による調達力の強化
- ・標準製品、システムパーツの拡充
(**FANアラームボード、標準部材等**)
- ・生産拡大に伴う生産設備増強

市場における優位性増大 = 事業拡大へ

(2) 受託範囲の拡大

当社の顧客メーカーは、部品をバラバラで調達する事をやめ、なるべくそのまま使えるユニット(完成体)で調達したいとする傾向にあります。

お客様が本来の研究開発活動にリソースを集中していただけるよう、当社の受託範囲がより完成品に近い形となるよう供給体制を整備・拡充し、お客様の多様なニーズに応えます。



年々構成レベルの高い（完成品に近い）製品に対する需要が増加する傾向

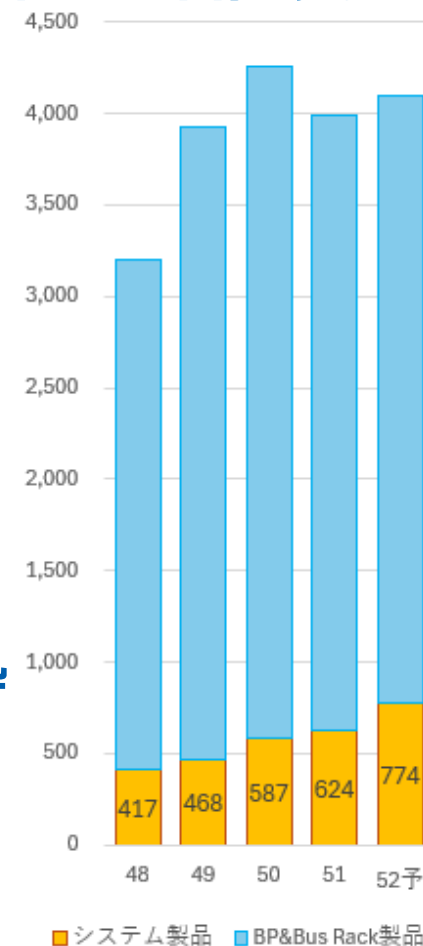
受託範囲の拡大による業績拡大

(3) ボードコンピュータ事業強化

技術革新で小型化・低消費電力化が進み、エッジコンピューティング、IoT等、小型ワンボードコンピュータを使用して実現するFAシステム、DX(Digital Transformation)関連のシステム開発に注力。パートナーシップを含む技術部門の増強を図り製品開発力の向上を目指す。

- ・ 高電圧・大容量直流遮断器（洋上風力発電向送電用途）
- ・ 半導体検査用制御装置（マイクロプロセッサ用途）
- ・ 次世代ワイヤーボンダーコントローラー（システム制御）
- ・ フィールドバス対応ロードセルアンプ（プラントシステム用途）
- ・ 高速モーションコントローラー（半導体製造装置用途）
- ・ AI画像処理システム（監視カメラ用途、FAカメラ用途等）
- ・ ショットピーニング用AEセンサーモジュール（FA用途）
- ・ 半導体製造装置用制御部（露光装置用途）
- ・ 除振装置用コントローラー（精密機械用途）

※現在進行中の開発案件抜粋



(4) 中国子会社の活用強化

中国の子会社(蘇州エブレン)の戦略的活用により、中国・台湾を中心とした技術力と価格競争力のある現地の部材調達先の開拓を推進します。現地企業および日系の進出企業へ現地生産によるコスト競争力のある製品を提供します。



蘇州惠普聯電子有限公司
概要

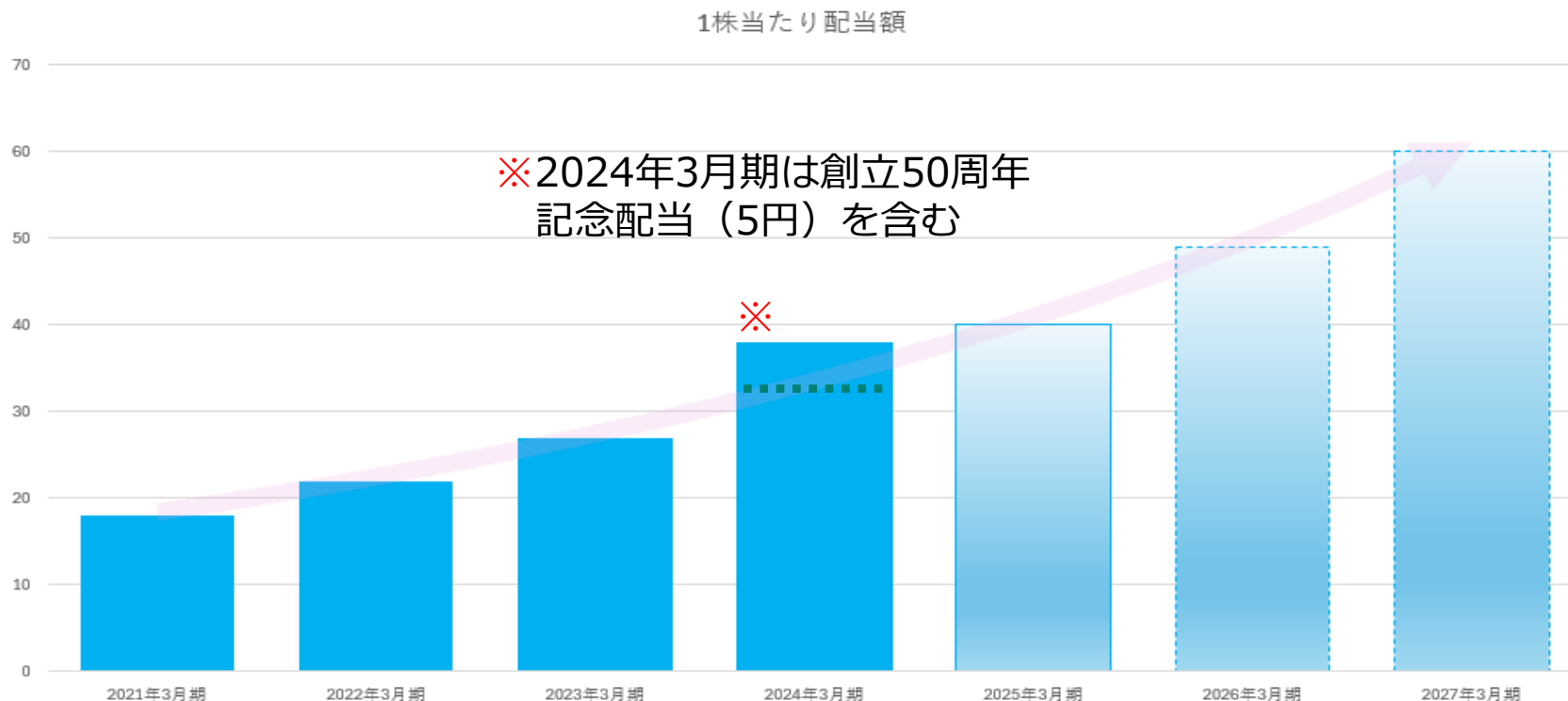
会社名	蘇州惠普聯電子有限公司
本社所在地	中華人民共和国江蘇省蘇州市
創業開始	2002年9月
資本金	82百万円
株主構成	当社100%
事業内容	バックプレーン及びバスラック等の製造販売及び輸出入、部材の現地生産調達先の開拓

安定した増配を継続

2020年の上場以来毎年22%の増配を継続しています。

2023年10月22日に創立満50年を迎えたため、2024年3月期は記念配当として、5円上乗せ配当を実施しました。

今後も安定した増配を継続する方針です。



注) 上記グラフは22%増配を継続した場合のグラフです。実際の配当額は業績等を勘案して決定します。この配当をお約束するものではありません。

本資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかわる仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予測数値とは異なる可能性があるため、本資料のみに全面的に依拠することは控えていただきますようお願い申し上げます。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、ご自身のご判断において行われますようお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。

EBRAIN